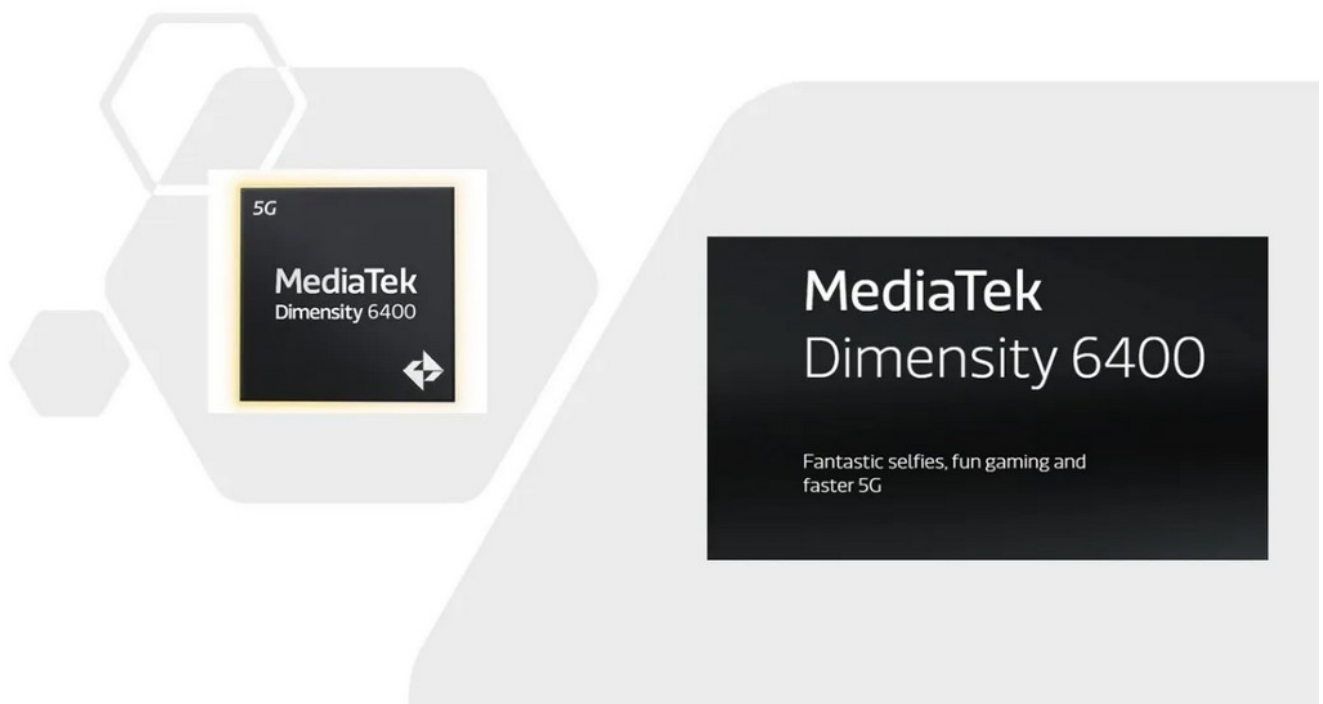


Dimensity 6400 de MediaTek, el nuevo SOC para la gama media

MediaTek acaba de lanzar el Dimensity 6400, su último chipset diseñado para dispositivos móviles de gama media. Este procesador es una versión renovada del Dimensity 6300, lanzado en 2024, pero con núcleos de rendimiento ligeramente más rápidos.

Cabe recordar que el Dimensity 6300 también era una actualización del Dimensity 6100+, presentado en 2023. Fabricado con la tecnología de 6 nm de TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), el Dimensity 6400 ofrece soporte para cámaras de hasta 108 megapíxeles, pantallas Full-HD con tasa de refresco de 120 Hz y conectividad 5G.



Especificaciones técnicas del MediaTek

Dimensity 6400

El Dimensity 6400 es un chipset octa-core fabricado en 6 nm, que integra dos núcleos Arm Cortex-A76 con una velocidad de reloj de 2.5 GHz y seis núcleos Cortex-A55 a 2 GHz.

Esta configuración es similar a la de sus predecesores, el Dimensity 6300 y el Dimensity 6100+, aunque con núcleos de rendimiento un poco más rápidos (2.4 GHz y 2.2 GHz, respectivamente). Además, cuenta con la GPU Arm Mali-G57 MC2, compatible con memoria RAM LPDDR4x y almacenamiento UFS 2.2.

El chipset también soporta pantallas AMOLED Full-HD+ (1,080 × 2,520 píxeles) con una tasa de refresco de hasta 120 Hz, lo que garantiza una experiencia visual fluida. En cuanto a fotografía, el Dimensity 6400 permite el uso de cámaras de hasta 108 megapíxeles, lo que lo convierte en una opción atractiva para los amantes de la fotografía móvil.

Processor	CPU Type(s)	2X Arm Cortex-A76 up to 2.5GHz 6X Arm Cortex-A55 up to 2.0GHz
	Cores	Octa (8)
	CPU Bit	64-bit
	Heterogeneous Multi-Processing	Yes
Memory & Storage	Memory Type	LPDDR4x
	Max Memory Frequency	2133MHz
	Storage Type	UFS 2.2
Graphics	GPU Type	Arm Mali-G57 MC2
Camera	Max Camera ISP	Native 108MP 16MP + 16MP
Display	Max Display Resolution	2520 x 1080
	Max Refresh Rate	Up to 120Hz + 3D LUT



Conectividad y disponibilidad en dispositivos

El Dimensity 6400 incluye un modem 5G compatible con el estándar 3GPP Release-16, capaz de alcanzar velocidades de descarga de hasta 3.3 Gbps. Además, ofrece soporte para redes 5G (SA/NSA), 4G LTE, 3G y 2G, así como conectividad Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 y GPS de doble banda.

Los entusiastas de los smartphones no tendrán que esperar mucho para ver este chipset en acción. El Realme P3x 5G, que se lanzará en India el 18 de febrero, será uno de los primeros dispositivos en integrar el Dimensity 6400.

Este modelo contará con una batería de 6,000 mAh y soporte para carga rápida de 45W. Además, estará certificado con las clasificaciones IP68 e IP69, lo que garantiza resistencia al polvo y al agua.

El MediaTek Dimensity 6400 se posiciona como una opción competitiva para los smartphones de gama media, combinando

rendimiento, eficiencia y conectividad avanzada.

Fuente: [pasionmovil](#).